

半導体封止材料の基礎と

1名分料金で
2人目無料

設計・製造の応用技術および半導体パッケージ動向

セミナーURLはこちら→ <https://www.rdsc.co.jp/seminar/250132>

- ◆日時:2025年1月29日(水) 10:30~16:30
- ◆【アーカイブ配信:1月30日(木)~2月13日(木)(何度でも受講可能)】
- ◆受講料:1名につき55,000円(税込、資料付)

会員(案内)登録していただいた場合、通常1名様申込で55,000円(税込)から
 ・1名で申込の場合、**49,500円(税込)**へ割引になります。
 ・2名同時申込で両名とも会員登録をしていただいた場合、**計55,000円(2人目無料)**です。

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

●講師:有限会社アイパック 代表取締役 越部 茂 氏

【受講対象・レベル】

- ・半導体関係者(技術者、営業等)で、パッケージング技術に関心のある方々
- ・半導体パッケージング全般(開発の経緯・動向等)に興味を持っている方々

【習得できる知識】

- ・半導体パッケージング全般の基本知識
- ・半導体パッケージの開発経緯および開発動向
- ・半導体パッケージング材料の基本知識
- ・半導体ビジネスにおける世界と日本のギャップ=日本の半導体が抱える問題

【講演の趣旨】

「半導体」は現代社会には不可欠である。半導体(ベアチップ)は、封止材料によりパッケージング(保護)され半導体装置(パッケージ)となる。このため、パッケージング技術(方法、材料)の知識が半導体の理解に役立つ。本セミナーでは、半導体のパッケージング技術を分かり易く説明する。封止材料の基本・応用情報だけでなく、半導体パッケージの開発動向に関して説明する。封止材料成分の分散性および安定性を高めるため、どのように設計を行うか?また、次世代半導体のパッケージングへの対応(課題と対策)についても解説する。

【プログラム】

1. 基本情報

- (1)封止材料の概要
- (2)PKG構造と樹脂封止
- (3)パッケージング技術と要求特性

2. 封止材料諸元

- (1)組成
- (2)製造・管理方法
- (3)評価方法

3. 封止材料用原料の基本知識

- (1)フィラー
- (2)エポキシ樹脂
- (3)硬化剤
- (4)硬化触媒
- (5)機能剤
- (6)放熱性フィラー

4. 封止材料設計における要点

- (1)配合目的の確認
- (2)材料成分の寸法
- (3)材料成分の配置
- (4)材料成分の管理
- (5)現行材料の課題

5. 半導体パッケージング技術進化への対応

- (1)スマートフォン用PKG;
軽薄短小高速化対応, AI対応(CPU・GPU)
- (2)車載用PKG・モジュール;
EV対応(高温動作保証), 自動運転対応(運転記録保全)
- (3)日本の半導体; 現状課題, 復活への模索

『半導体封止材料』セミナー申込書 <■LIVE ■アーカイブ> ※いずれかにチェックしてください

会社・大学			
住所	〒		
電話番号		FAX	

お名前	所属・役職	E-Mail
①		
②		

会員登録(無料) ※案内方法を選択してください。複数選択可。

Eメール 郵送

● セミナーの受講申込みについて ●

必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下さい。弊社で確認後、必ず受領のご連絡をいたします。受講用URLは後日お送りいたします。

セミナーお申込み後のキャンセルは基本にお受けしておりませんので、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

お申込み・振込に関する詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>

個人情報保護方針の詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>